

Aandelen BESI 15% lager: dit is waarom

8 mrt 2024 om 17:15

De meest opvallende daler op de Nederlandse beurs vandaag is met afstand **BE Semiconductor Industrie (BESI)**. Na een enorme koersrally die eigenlijk al gaande is sinds oktober vorig jaar daalt de koers van de aandelen vandaag met ongeveer 12%.

Wat is er aan de hand? In dit artikel meer uitleg en duiding over de flinke, plotselinge koersdaling van aandelen BESI.

Koers opent lager en zakt verder weg

Vanochtend bij beursopening was nog niet iedereen duidelijk wat er precies aan de hand was met aandelen BESI. Terwijl aandelen ASML en ASM International aanvankelijk nog licht in het groen noteerde bleef de aandelenkoers van BESI verder wegzakken.

Nadat twee andere Amerikaanse bedrijven actief in de semiconductor industrie gisteravond kwartaalcijfers rapporteerde (Broadcom + Marvell) die niet positief werden ontvangen door beleggers was wellicht daar een mogelijke verklaring te vinden.

Op Twitter verwees men al gauw naar een analistenrapport van Kempen waar BESI van de kooplijst gehaald werd. Het koersdoel van 170 euro dat werd afgegeven biedt namelijk weinig ruimte voor verdere koersstijging. Maar ook dat analistenrapport bleek niet de aanleiding van de hevige daling vandaag.

Boosdoener blijkt mediabericht Korea

Alhoewel niet makkelijk te vinden werd duidelijk dat een bericht in de Koreaanse media de aanleiding blijkt te zijn. Hier via [deze link](#) kun je het

artikel vinden. Aangezien de tekst in het Koreaans is kun je met Google Translate de pagina vertalen naar het Engels.

\$BESI boosdoener artikel hieronder

– Agreement to ‘relax’ HBM4 thickness standard... Samsung, SK postpone introduction of hybrid bonding

– HBM4 standard 775 micrometer adopted... Can also be implemented using existing packaging technology [\\$TSM](#) [\\$INTC](#) <https://t.co/PNdSeeDz6r>

— Jordy Beuving (@BeuvingJordy) [March 8, 2024](#)

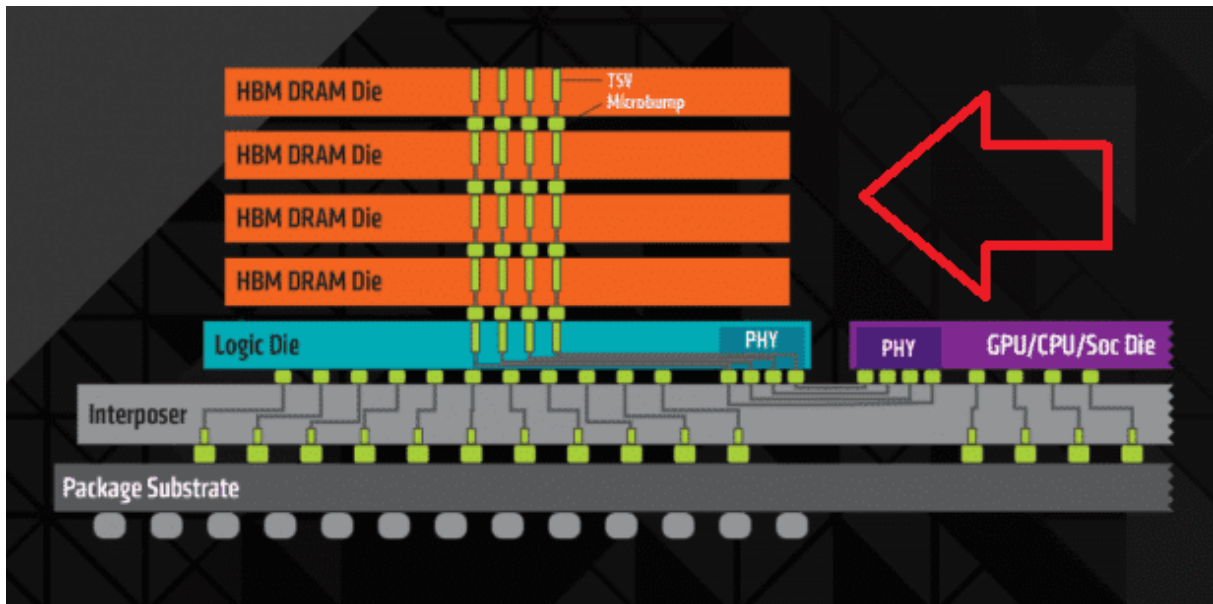
Wat staat er in het artikel?

Samengevat wordt er aangegeven dat de grote spelers in de geheugenchipsector, zoals SK Hynix en Samsung (lees: klanten van BESI), voor zogeheten HBM4-toepassingen waarschijnlijk (nog) geen Hybrid Bonding techniek zullen gaan toepassen. Anders gezegd: de adoptie van Hybrid Bonding gaat wellicht wat langzamer dan mogelijk was geweest.

Nu zul je je afvragen waarom. Een technisch verhaal waarbij enige uitleg benodigd is om goed te begrijpen wat precies de impact hiervan kan/gaat zijn voor BESI.

Het heeft namelijk te maken met HBM4, de allernieuwste generatie *High Bandwith Memory* waarbij meerdere geheugenchips (DRAM) op elkaar ‘gestapeld/geplakt’ worden.

Zie hieronder ter illustratie een foto van AMD voor een beeldvorming waarbij er 4 van deze geheugenchips op elkaar gestapeld zijn:



(Bron: AMD)

HBM4 is de allernieuwste generatie die tegen 2026 commercieel moet worden gelanceerd. Hierbij zijn er niet 4 van deze chips op elkaar 'gestapeld' zoals in de afbeelding maar moeten er uiteindelijk 12 of zelfs 16 van deze geheugenchips op elkaar 'gestapeld' worden.

Deze assemblage­stap van het 'stapelen' is precies waar BESI zich op richt met haar chip­machines. Hybrid Bonding is daarbij de nieuwste techniek die in de toekomst vermoedelijk industrie­breed gebruikt zal gaan worden omdat dit proces steeds complexer wordt.

In het artikel stelt men dat er door grote spelers in de industrie onder de *International Semiconductor Standards Organization* een bepaalde technologische standaard is afgesproken voor de zogeheten '*package thickness*' van HBM4. Namelijk 775 μm in plaats van 720 μm .

Wat maakt dit nou uit, zul je wellicht denken. Het artikel geeft aan dat voor de technologische standaard 775 μm geen hybrid bonding techniek noodzakelijk is en dat ook de huidige generatie assemblagemachines (TCB) kunnen volstaan.

Nu kennelijk deze standaard is afgesproken lijkt het erop dat spelers in de industrie mogelijk de bestaande technologieën zullen gebruiken voor HBM4, al dan niet in combinatie met hybrid bonding.

Hybrid bonding is een stuk duurder en complexer in vergelijking met traditionele assemblagemachines. Indien het niet noodzakelijk is om te gebruiken en traditionele assemblagetechnieken kunnen volstaan dan valt dit besluit goed te volgen.

Wat betekent dit voor BESI?

Voor BESI natuurlijk geen goed nieuws. Het zou kunnen betekenen dat grote investeringen in hybrid bonding langer op zich kunnen laten wachten dan wellicht gedacht aangezien de voorgaande generaties assemblagemachines geschikt blijven.

Gelet op de voorgaande kwartalen en earnings calls zit er duidelijk schot in de zaak voor wat betreft de adoptie van hybrid bonding, maar dit zou wel degelijk een tegenvaller betekenen voor wat betreft het tempo van adoptie.

De lange termijn verwachtingen voor de toepassingen van hybrid bonding blijven ondanks deze berichtgeving intact. Uitstel is gelukkig geen afstel.

In my opinion, this could, if proven true, phase out part of Besi's HB revenue from 2024 to 2025, not cancel it, just delaying it. [#long](#)

— Marc Langeveld (@beurstier68) [March 8, 2024](#)

Toch moge het duidelijk zijn dat dit geen goed nieuws is voor BESI en de koersdaling vandaag valt dan ook goed te begrijpen. Zeker met inachtneming van de enorme koersrally de afgelopen maanden waarbij de fantasie en adoptie omtrent hybrid bonding een belangrijk deel uitmaakt van de koersstijging.

Even pas op de plaats dus. Wordt ongetwijfeld vervolgd en dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Goed weekend,

Jordy

